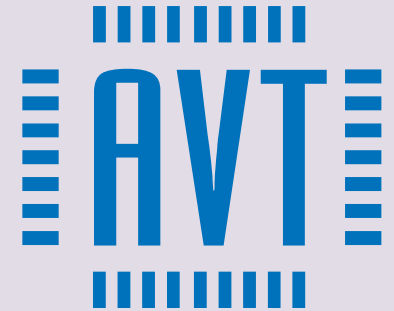


# Institutskolloquium Aufbau- und Verbindungstechnik 2004



[www.avt.et.tu-dresden.de](http://www.avt.et.tu-dresden.de)

Termin: 15. September 2004

Ort: TU Dresden  
Görgesbau  
Hörsaal 226  
Helmholtzstr. 9  
01069 Dresden



Technische Universität Dresden  
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik  
Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik  
und Zentrum für mikrotechnische Produktion

## Anmeldung:

Die Teilnahme am Institutskolloquium Aufbau- und Verbindungstechnik 2004 ist gebührenfrei.

Für die organisatorische Vorbereitung der Veranstaltung erbitten wir dennoch Ihre Anmeldung. Verwenden Sie bitte dazu nebenstehendes Formular.

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung, Anfahrtsskizze und organisatorische Hinweise per Email. Bitte vergessen Sie daher nicht, Ihre korrekte Email-Adresse auf dem Anmeldeformular anzugeben.

Tagungsunterlagen, Mittagsimbiss und Pausenversorgung stehen den Teilnehmern ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Sollten Sie aus nicht vorhersehbaren Gründen kurzfristig Ihre angemeldete Teilnahme absagen müssen, so bitten wir um sofortige Benachrichtigung.

## Veranstaltungsort:

Technische Universität Dresden  
Görgesbau, Hörsaal 226  
Helmholtzstr. 9  
01069 Dresden

## Organisation:

Dr.-Ing. T. Zerna

Tel.: 0351 - 463 332 74

Fax: 0351 - 463 370 69

Email: [zerna@zmp.et.tu-dresden.de](mailto:zerna@zmp.et.tu-dresden.de)

Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

## Anmeldung

Ich nehme am Institutskolloquium Aufbau- und Verbindungstechnik 2004 am 15. September 2004 in Dresden teil.

Fax an:

0351 - 463 370 69

TU Dresden

Institut für Aufbau- und  
Verbindungstechnik der Elektronik

01062 Dresden

Name, Vorname, Titel

Firma, Abt.

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

# Institutskolloquium

## Aufbau- und Verbindungstechnik

### 2004

**Mittwoch, 15. September 2004**

*Vor einem Jahr wurden, ausgehend von personellen und strukturellen Veränderungen, an unserer Fakultät die Ressourcen in Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet des "Electronic Packaging" gebündelt. Um diesem Konzentrationsprozess und auch der Erweiterung des fachlichen Inhalts äußerlich Rechnung zu tragen, benannte sich unser Institut per 1.10.2003 um in "Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik".*

*In enger Synergie mit dem "Zentrum für mikrotechnische Produktion", einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung unserer Fakultät und eines der Transferzentren im Kompetenznetzwerk "Mikrotechnische Produktion", sind insgesamt 40 Mitarbeiter in Forschung, Ausbildung und Weiterbildung sowie Know-How-Transfer tätig.*

*Unser fachliches Spektrum umfasst dabei sowohl die Grundlagen der Technologien elektronischer Baugruppen auf der Basis organischer und anorganischer Substrate, als auch verschiedene Spezialgebiete. Als Beispiele seien genannt: Biokompatible AVT, Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Simulation und Optimierung von Fertigungsprozessen und andere.*

*Mit dem "Institutskolloquium Aufbau- und Verbindungstechnik" möchten wir eine Veranstaltungsreihe ins Leben rufen, die unseren engen Kontakt zu Interessenten aus Industrie und Wissenschaft weiter vertiefen hilft. Sowohl diejenigen, die schon seit vielen Jahren erfolgreich mit uns zusammenarbeiten, als auch jene, die uns noch kennen lernen möchten, sind herzlich eingeladen, an einem "Tag der Wissenschaft" sich in Vorträgen ein Bild von unserer Forschungstätigkeit zu verschaffen als auch im wörtlichen Sinne Einblick in unsere Laborräume zu erhalten.*

*Seien Sie am 15. September unsere Gäste in Dresden. Ich lade Sie hierzu herzlich ein.*

*Prof.Dr.-Ing.habil. K.-J. Wolter  
Direktor des IAVT  
Direktor des ZµP*

ab 9:30	<b>Anmeldung und Ausgabe der Tagungsunterlagen</b>	
10:00	<b>Eröffnung</b>	Prof.Dr.-Ing.habil. Klaus-Jürgen Wolter
10:15	<b>Adhäsionsverbesserung im Packaging - Herausforderungen und Ergebnisse beim Einsatz umweltfreundlicher Materialien</b>	Dr.-Ing. Thomas Herzog
10:40	<b>Thermosonic-Drahtbonden ohne Substratheizung</b>	Dipl.-Ing. Markus Wohnig
11:05	<b>Biokompatible Aufbau- und Verbindungstechnik - Schnittstelle zwischen technischem und biologischem System</b>	Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann
11:30	<b>Aktuelle Forschungsergebnisse zu passiven Dickschichtbauelementen</b>	Dr.-Ing. Lars Rebenklau
12:00	<b>Mittagsimbiss</b>	
13:00	<b>Mechanische Simulationen in der Aufbau- und Verbindungstechnik</b>	Dr.-Ing. Steffen Wiese
13:25	<b>Methoden zur signifikanten Qualitätsverbesserung in der SMT-Fertigung - ein Überblick</b>	Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe
13:50	<b>Optimierte Maschinenbelegungsplanung in der Leiterplattenfertigung</b>	Dr.-Ing. Gerald Weigert
14:15	<b>Entwicklungstrends in der Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik</b>	Dr.-Ing. Thomas Zerna
14:40	<b>Kaffeepause</b>	
15:15	<b>Vorfürungen in den Labors des Instituts für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik und des Zentrums für mikrotechnische Produktion</b>	
17:30	<b>Get together</b>	